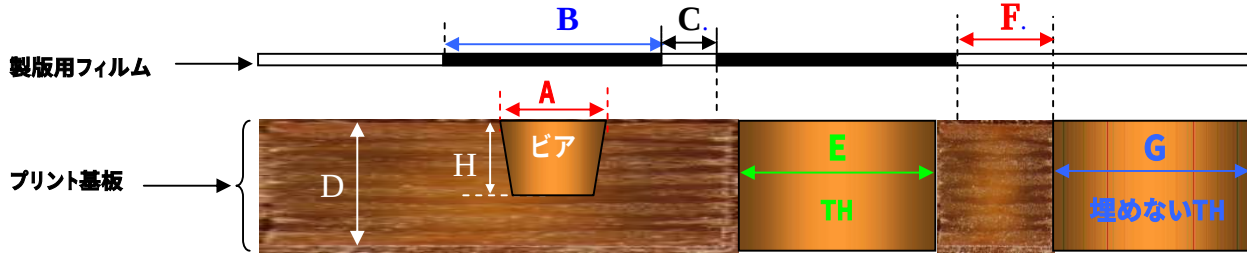


有底ビアプラグ加工仕様

(株)野田スクリーン
登録日 2012年05月11日



1) 加工基本仕様 (下記から1点でも外れるものはツール手配前に事前打合せ要)		
項目	加工仕様	注記
①ワークサイズ	□ 255 ~ 515×615 mm	範囲外は事前検討が必要
②板厚 (D)	$0.12 \leq D \leq 6.50$ mm	基材厚の最薄は0.10mmまで
③-1 ビアTop径 (A)	$0.05 \leq A \leq 0.30$ mm	樹脂系インクに適用
アスペクト比 (H÷A)	1 以下	
③-2 ビアTop径 (A)	$0.08 \leq A \leq 0.15$ mm	金属系インクに適用
アスペクト比 (H÷A)	1 以下	
④TH径 (E)	$0.10 \leq E \leq 0.80$ mm	
⑤フィルムドット接近最小距離 (C)	0.05mm以上	0.05mm未満は事前検討が必要
⑥TH加工エリア	基板端面から10mm以上離れること	充填するTH対象
⑦穴埋め印刷固定用ガイド穴	$2.00 \leq \text{ガイド穴} \leq 3.50$ mm	弊社在庫にあるガイドピンサイズ
⑧ハーフエッチ	$15 \mu \leq \text{仕上がり導体厚}$ 粗い値	基礎銅箔エッチング品は除く 最小エッチング量 $4 \mu \text{m}$

2) 加工に際してその他注意事項		
項目	注意事項	注記
①表面導体厚切削量	標準 $3 \sim 5 \mu \text{m}$	標準フローでの参考値
②充填しないTH径 (G) 1	1.00mm以下	ハフカス詰まり発生リスク有り
③充填しないTH径 (G) 2	2.00mm以上	エッジ切れリスク有り
④充填しないTHと充填するTH製版用フィルムエッジ間距離 (F)	0.15mm以上	満たない場合、インクのズレ込みのリスク有り ※アスペクト比12以上は事前検討が必要
⑤インク	UV硬化インク(DC5-4)は不可	
⑥表面状態	表面粗化処理は不可	処理有りの場合粗化面除去が必要

3) NSツール手配と必要情報及びデータ支給について	
項目	記載事項
①新規製品情報通知書 (別紙)	ワークサイズやインク種がツール準備に必要となります
②フィルム作製 (フィルム顧客支給の場合は4)へ別紙参照 [特殊印刷品のツール作製])	穴埋め用データ (NCDリリデータ) を支給願います ※充填するTHやしないTH、ガイド穴などでの特別指示は、ツール番号表にてご連絡下さい ※同じツール番号で充填しないTHがある場合、充填するTHのみのデータをご準備下さい ※両面印刷の場合、ガイド穴は充填ビアより外側に3点必要です。
③スクリーン版作製	上記支給フィルムまたはNS手配フィルムにて作成
④治具板作製	NCDリリデータを支給願います (②で支給いただいた場合は不要です)
⑤穴埋め用データ支給日(リードタイム)	加工開始予定日の前日朝までに支給願います。②-④の作成に1日必要

4) 製版用フィルム支給について	
項目	記載事項
①フィルム膜面	支給して頂くデータと同様の面視で充填するTHのみ黒点・膜上にて出力願います
②フィルム点径	下記表5)に記載された基準値で出力願います
③フィルム寸法補正	X、Y 0%にて支給願います (寸法差が著しい場合は、リピート時別途相談になります)

5) 顧客支給の製版用フィルム点径設定 (単位:mm)			
ビア径 (A)	$0.05 \leq A < 0.15$	$0.15 \leq A < 0.25$	$0.30 \leq A$
フィルム点径 (B)	0.4	A+0.25	事前確認要

※充填する貫通THの製版用フィルム点径設定は、フラットプラグ加工仕様を参照

6) その他事項	
項目	記載事項
①仕様外加工製品	有底プラグ加工仕様から外れる製品加工については、個別に調整させて頂きます。
②新規製品情報通知書	製造部 生産管理課のメールアドレス seikan@nodascreen.co.jp へ配信願います。
③NCデータ	製造部 生産管理課のメールアドレス seikan@nodascreen.co.jp へ配信願います。
④製版用支給フィルム	製造部 生産管理課宛 に発送をお願いします。